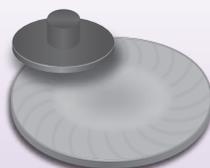


エレクトロニクス分野において 倉本産業の粘着シートは幅広く使われています。

半導体



ダイシング
(ウエハ切断)



裏面研削
(薄型化)

ダイシングシートX3203A, X5722Aなど

- ・エキスパンド性
- ・UV剥離

BGシートX4645Bなど

- ・UV剥離

表面処理

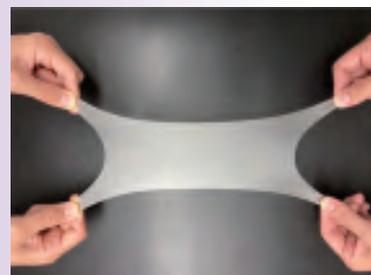


金属箔へ特殊なフィルムを貼り合わせ、箔側をエッチングする事で回路を形成します。

エッチング工程用シート#4051

- ・耐薬品性
- ・再剥離性

ウェアラブル



ベースシートX9777A

- ・薄膜
- ・伸縮性

粘着設計 成膜技術

ディスプレイ



バックライト用シート#4917

- ・遮光性

組立用両面シート#6500

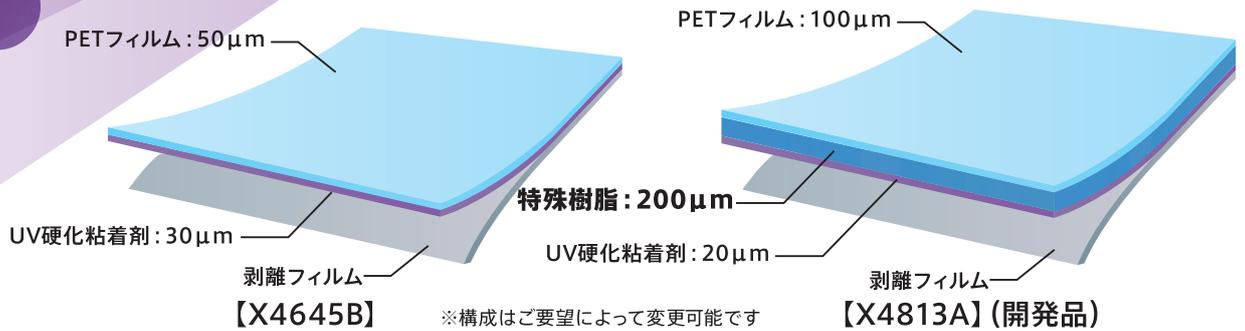
- ・難黄変 (UV吸収)
- ・強粘着

開発品

バックグラインドシート

半導体製造工程で使用可能な
UV硬化タイプのバックグラインドシートです

構成



特長

- UVを照射することで粘着力が低下し、糊残りなく剥がせます
- 特殊樹脂層は厚くても凝集性があり、加工性に優れます
- 表面の微小凹凸部分へ追従します

基本物性

粘着力測定結果

粘着力 [N/25 mm]

	X4645B	X4813A
常態	21	7.2
UV 後	0.06	0.8

被着体: SUS板
UV照射条件: メタルハライドランプ 積算光量 300 mJ/cm²

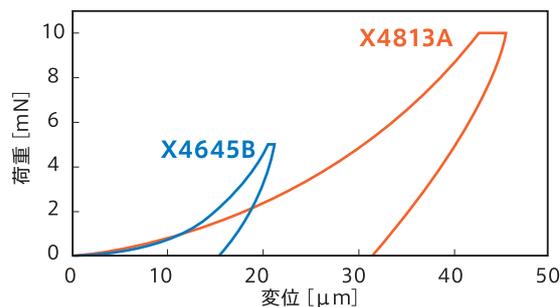
保持力測定結果

保持力 [mm]

	X4645B	X4813A
常態	0.3	0
80°C	0.3	0

被着体: SUS板
試験条件: 9.8N荷重、1h

硬さ試験結果

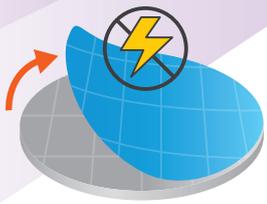


試験条件
圧子: バーコピッチ (三角錐)
最大荷重: X4645B 5 mN
X4813A 10 mN

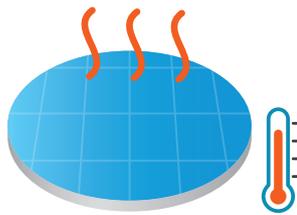
工程用テープ

片面粘着・両面粘着

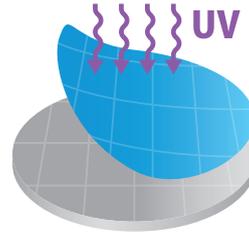
加工条件に合わせた設計、選定が可能



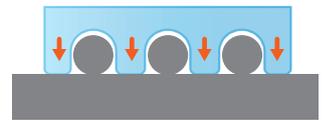
帯電防止性



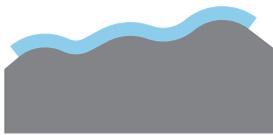
耐熱性



UV剥離



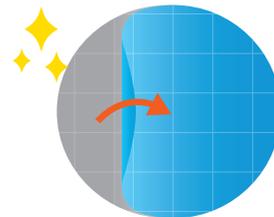
凹凸吸収性



曲面追従性



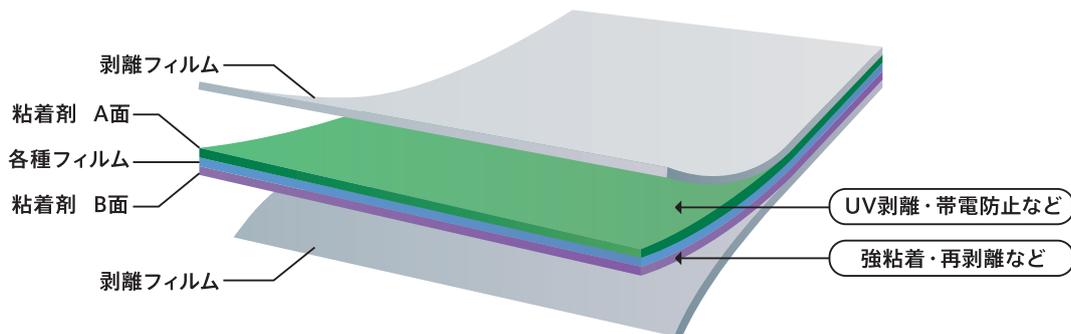
耐薬品性



再剥離性

基 材	PI、PEN、PET、PVC、PO など
粘 着 剤	UV剥離、帯電防止、耐熱、水溶性、着色など

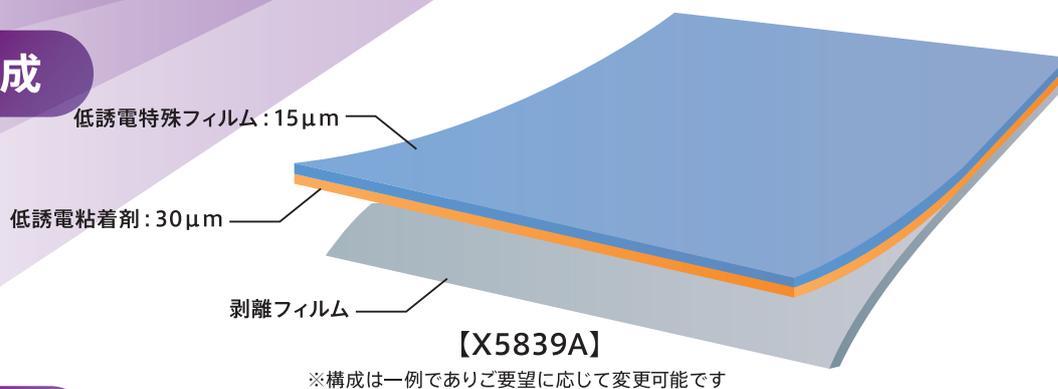
■ 例えば…両面テープの粘着剤A面、B面に異なる性能を付与



低誘電粘着シート

次世代高速通信技術 (5G,6G) 向けに開発した
低誘電粘着シートです

構成



※構成は一例でありご要望に応じて変更可能です

特長

- 誘電率の低い特殊なフィルムと粘着剤を用いた低誘電粘着シートです
- 低誘電性と粘着性の両立が可能で、後付けや再剥離性に優れています

基本物性

誘電特性 (測定: 共振法、周波数: 80GHz)

	誘電率	誘電正接
X5839A	2.40	0.0080

粘着物性

試験項目	粘着力 [N/10 mm]	保持力 [mm]	ボールタック [No.]
X5839A	2.7	0	7
測定方法	貼付後 20min	9.8 N 荷重, 1h	J.Dow 法 ($\theta = 30^\circ$)

※基材が軟質の為、25 μ m厚PET粘着シートで補強して測定しています

使用用途

- 次世代高速通信部材の回路基板やアンテナなどに使用される粘着シートとして
- 後付け、再剥離可能な特長を活かした現行製品、設備への高速通信部材の施工用として

